

株式会社 東京精密 2016年度(平成29年3月期) 決算説明会

2017年5月12日
株式会社東京精密
代表取締役社長CEO 吉田 均

*

将来の事象に係わる記述に関する注意

- ◆ 本プレゼンテーション資料にて提供する情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- ◆ これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- ◆ 従って、今後の当社の実際の業績が、本プレゼンテーションにおける記述と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

2016年度 通期業績

単位: 億円

	15年度	16年度		16年度 2月予想	予想対比 (億円)
	通期実績	通期実績	前期比		
売上高	703	778	+11%	725	+53
半導体製造装置	418	503	+20%	465	+38
計測機器	285	275	- 4%	260	+15
営業利益	132	137	+3%	130	+7
半導体	73	88	+20%		
同率	18%	18%	-		
計測	59	48	- 18%		
同率	21%	18%	-		
経常利益	132	139	+5%	128	+11
親会社株主に帰属する 当期純利益	97	99	+2%	94	+5
1株配当	59円	72円	+13円	68円	+4円



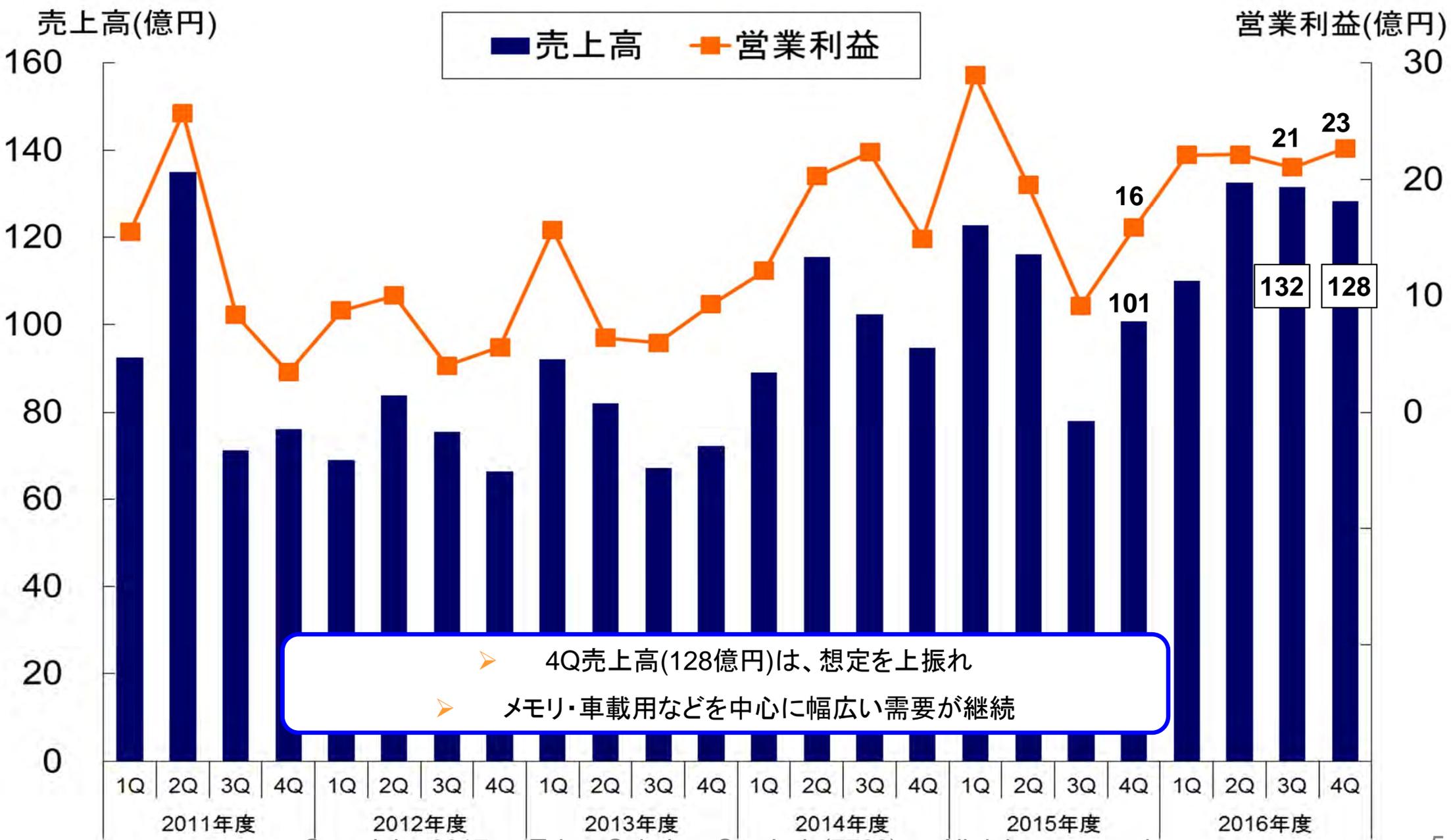
2016年度 第4四半期業績

単位: 億円

	15年度				16年度					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前 四半期比 Q/Q	前年 同期比 Y/Y
売上高	184	196	144	179	163	209	195	211	+8%	+18%
半導体	123	116	78	101	110	133	132	128	- 2%	+27%
計測	61	80	66	78	53	76	63	83	+30%	+6%
営業利益	39	38	22	34	29	37	32	39	+24%	+16%
半導体	29	20	9	16	22	22	21	23	+8%	+43%
同率	24%	17%	12%	16%	20%	17%	16%	18%	-	-
計測	10	18	13	18	6	15	11	16	+57%	- 8%
同率	16%	22%	19%	23%	12%	20%	17%	20%	-	-
経常利益	39	37	23	32	26	37	35	41	+18%	+26%
親会社株主に帰属する 当期純利益	28	27	17	25	19	28	14	39	+183%	+55%

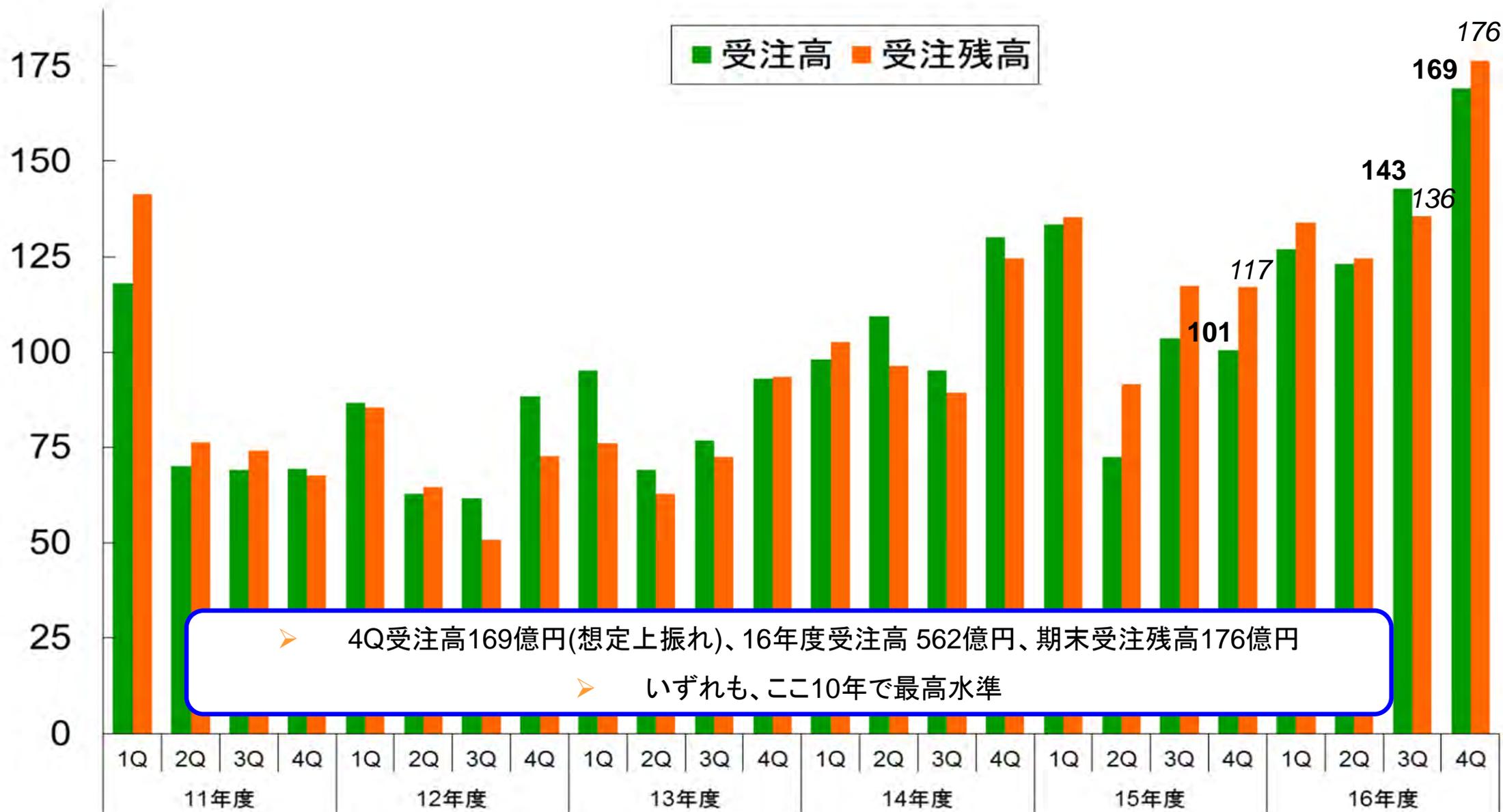


半導体事業 - 売上・営業利益推移



半導体事業 - 受注・受注残高推移

(億円)



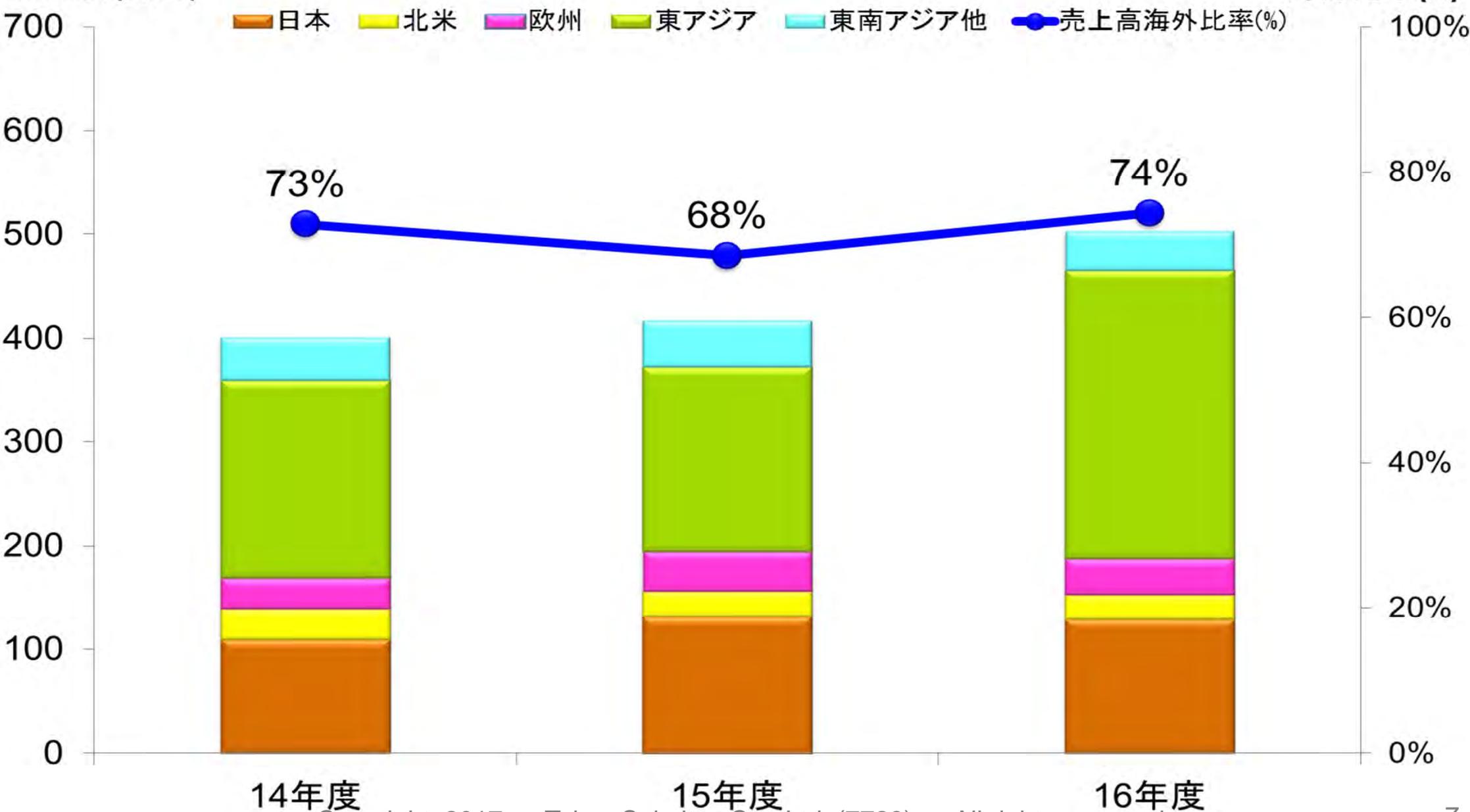
➤ 4Q受注高169億円(想定上振れ)、16年度受注高 562億円、期末受注残高176億円
 ➤ いずれも、ここ10年で最高水準



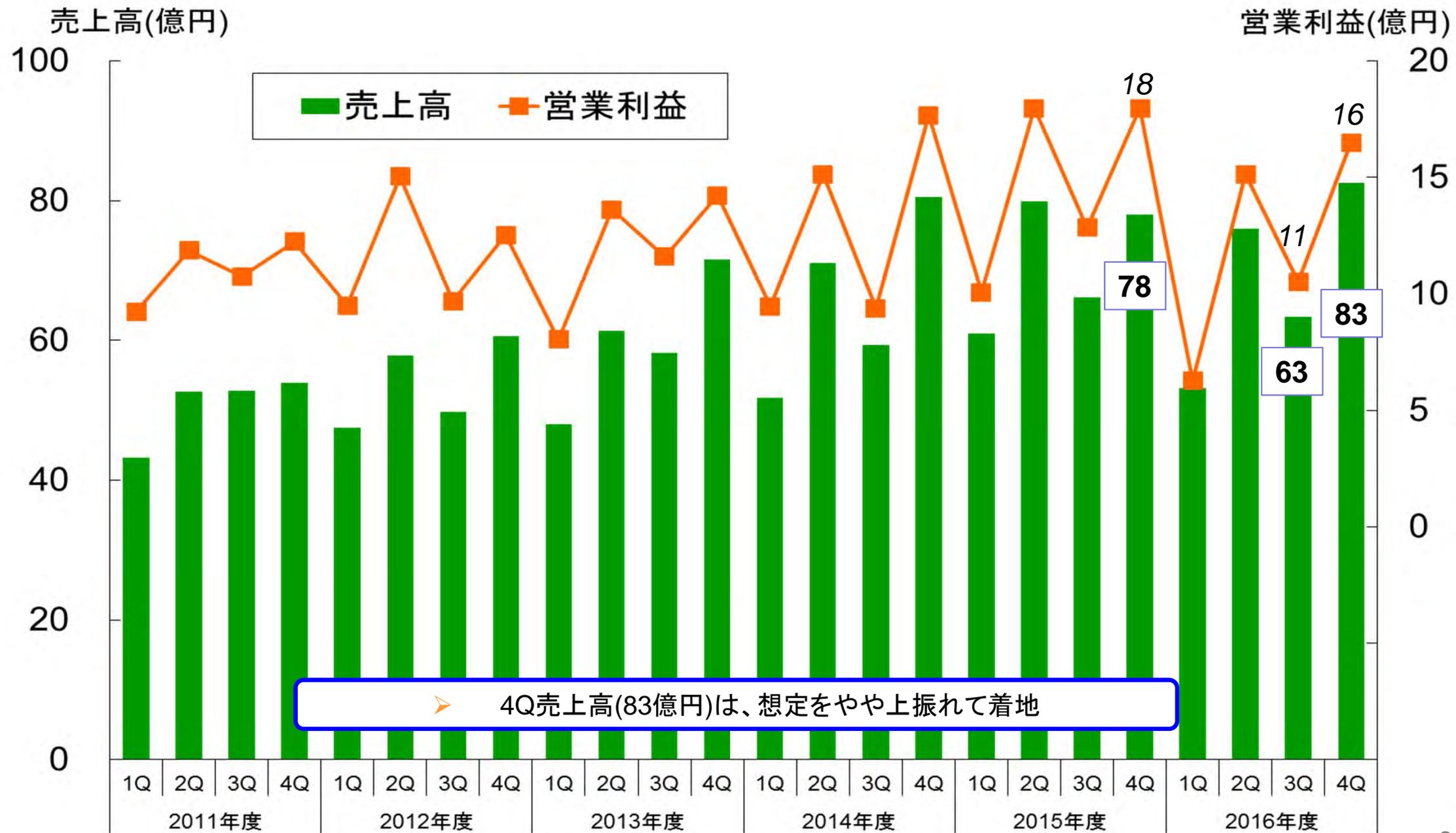
半導体事業 - 地域別売上高推移

売上高(億円)

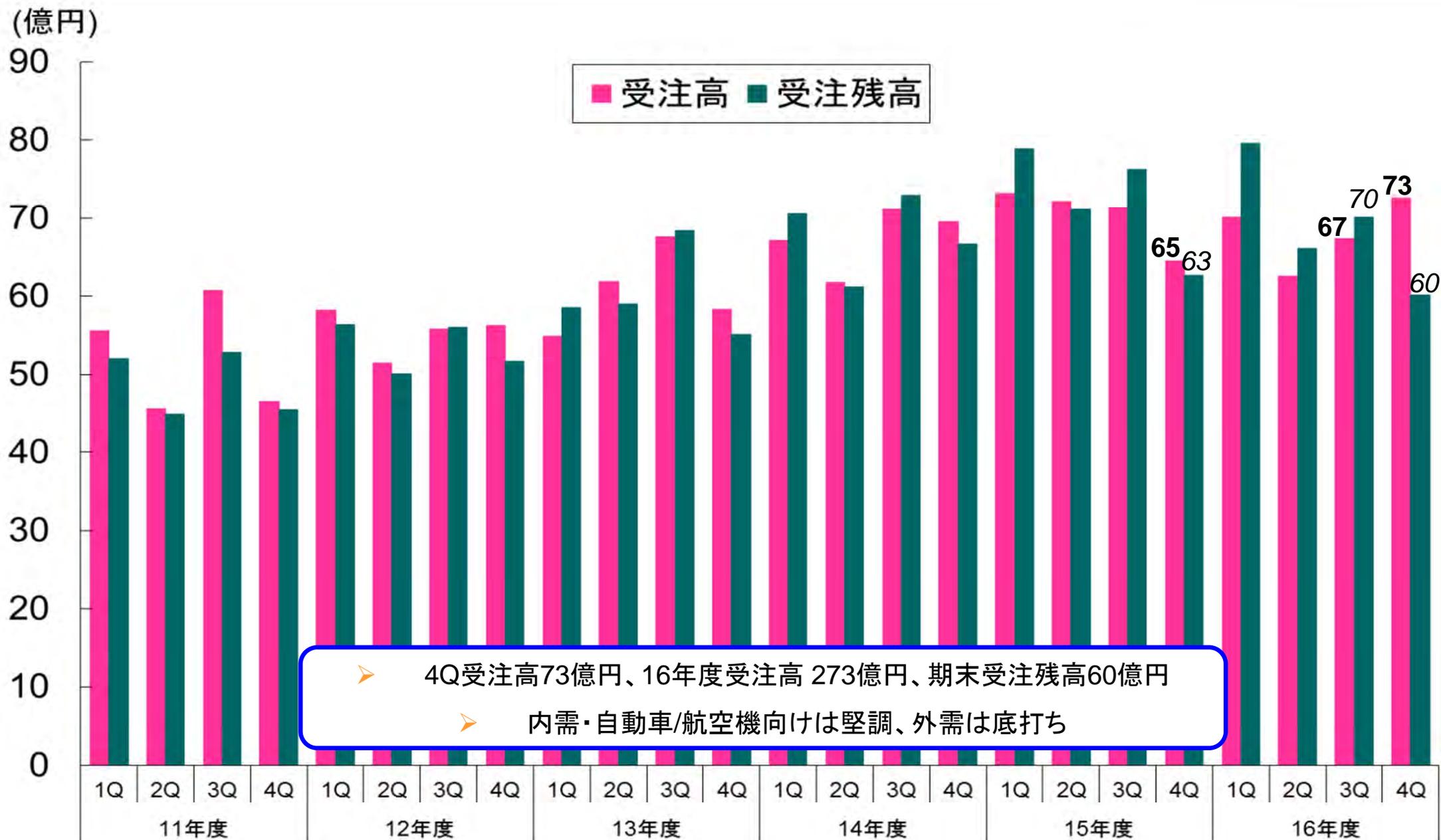
海外比率(%)



計測事業 - 売上・営業利益推移



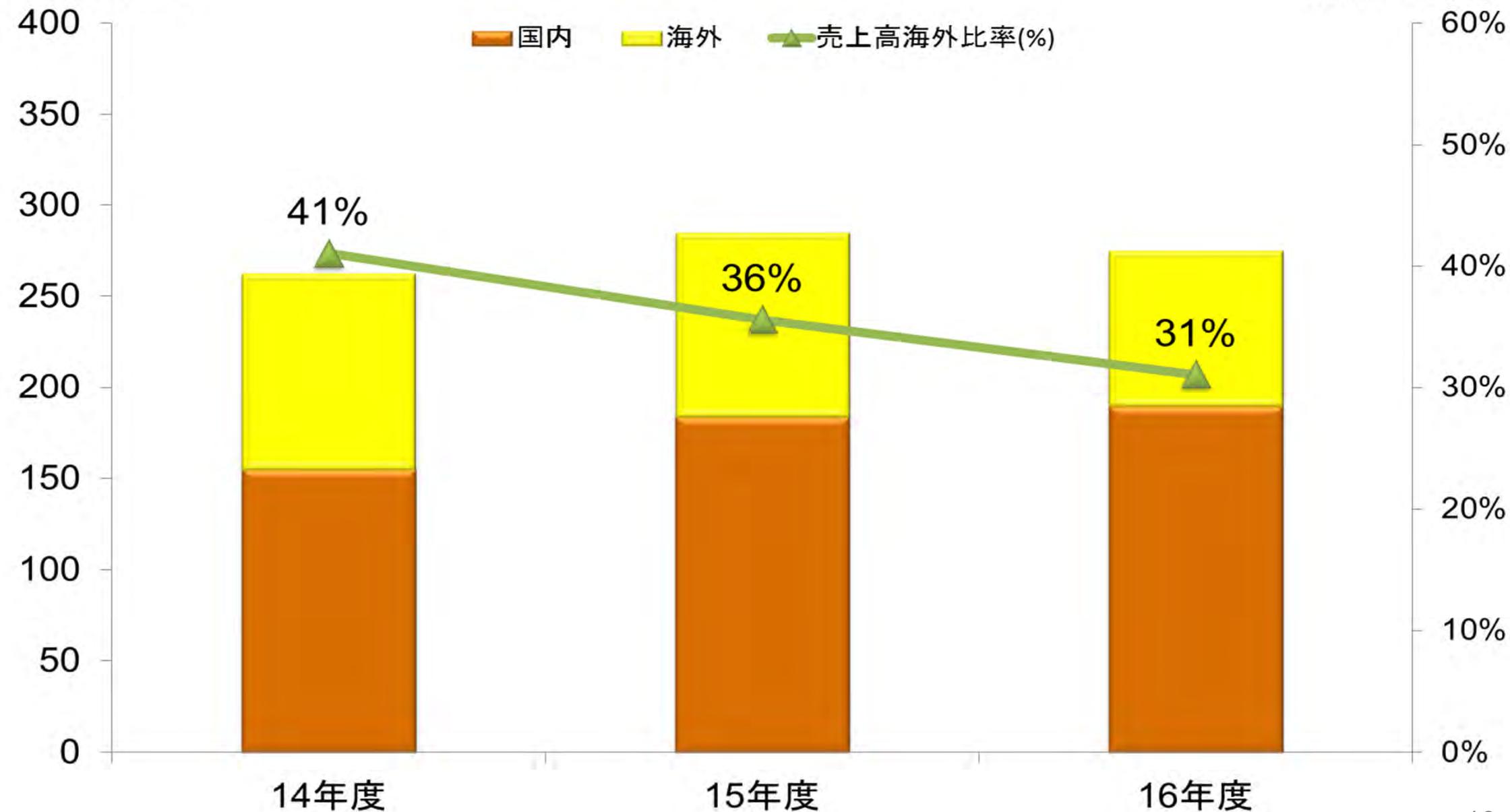
計測事業 - 受注・受注残高推移



計測事業 - 地域別売上高推移

売上高(億円)

海外比率(%)



2016年度 貸借対照表

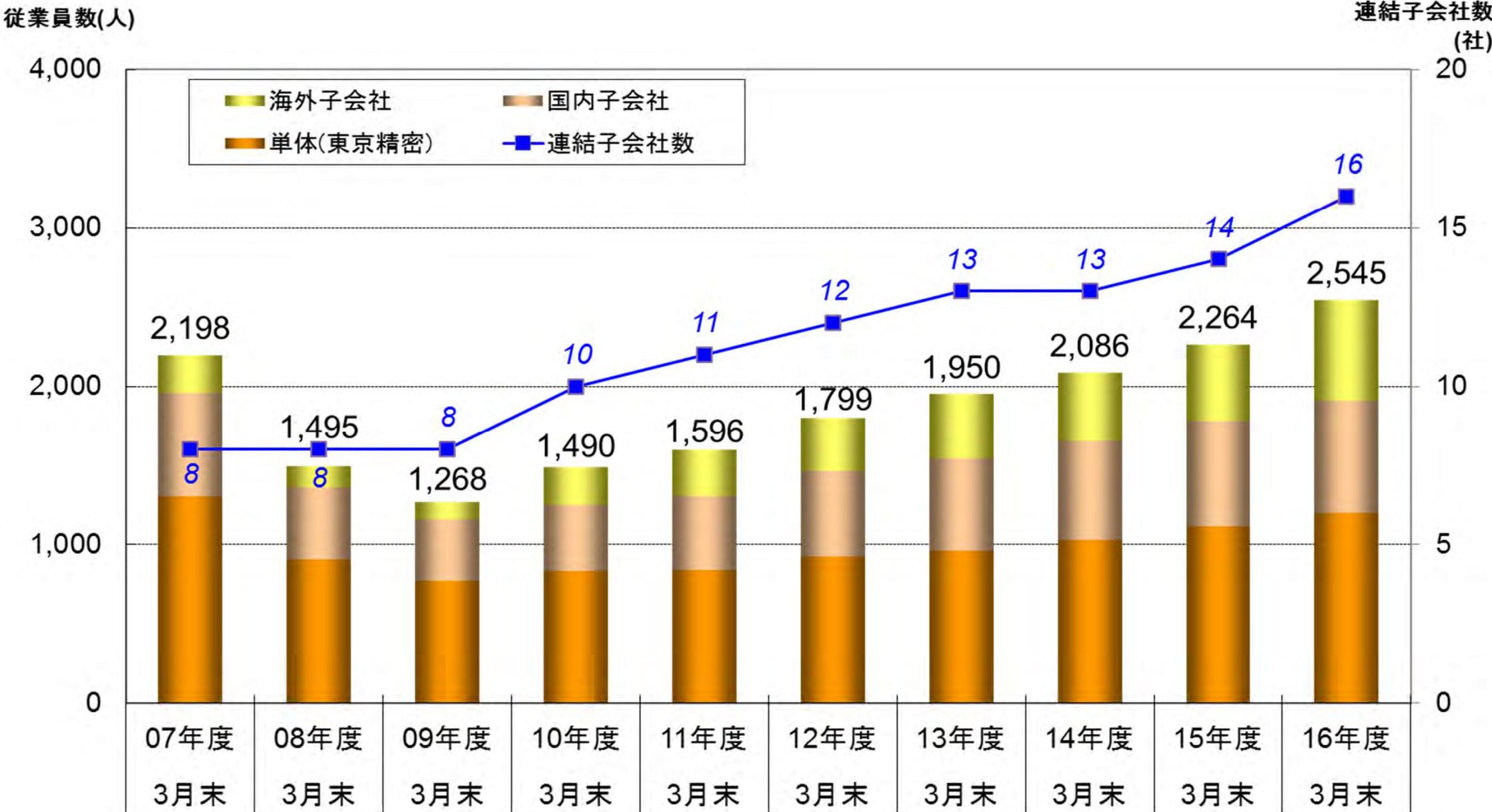
資産 (億円)	16/3末	17/3末	増減	負債/純資産 (億円)	16/3末	17/3末	増減
現預金	274	339	+65	支手・買掛金, 電子記録債務	118	158	+40
受取手形・ 売掛金・ 電子記録債権	260	284	+24	短期借入金	12	13	+1
在庫	161	173	+12	その他	84	95	+11
その他	32	32	- 0	流動負債計	214	266	+52
流動資産計	727	828	+101	固定負債計	11	7	- 4
固定資産計	292	317	+24	負債計	225	273	+48
資産合計	1,019	1,145	+125	純資産	794	872	+78
				負債・純資産合計 (内有利子負債)	1,019 (16)	1,145 (13)	+125 (- 3)

2016年度 キャッシュフロー

単位:億円		14年度	15年度	16年度
現金等 期首残高		204	268	273
営業活動	税引前・償却前利益	151	155	169
	(売上債権+在庫) - 仕入債務	- 20	- 42	- 1
	納税	- 21	- 38	- 36
	その他	- 2	- 3	- 4
小計		108	72	128
投資活動		- 30	- 38	- 35
フリーキャッシュフロー		79	34	93
財務活動	社債・借入	- 4	- 5	- 3
	株式・配当金、他	- 14	- 23	- 26
	小計	- 18	- 28	- 30
増減額(含 換算差額・連結範囲変更)		64	5	65
現金等 期末残高		268	273	338

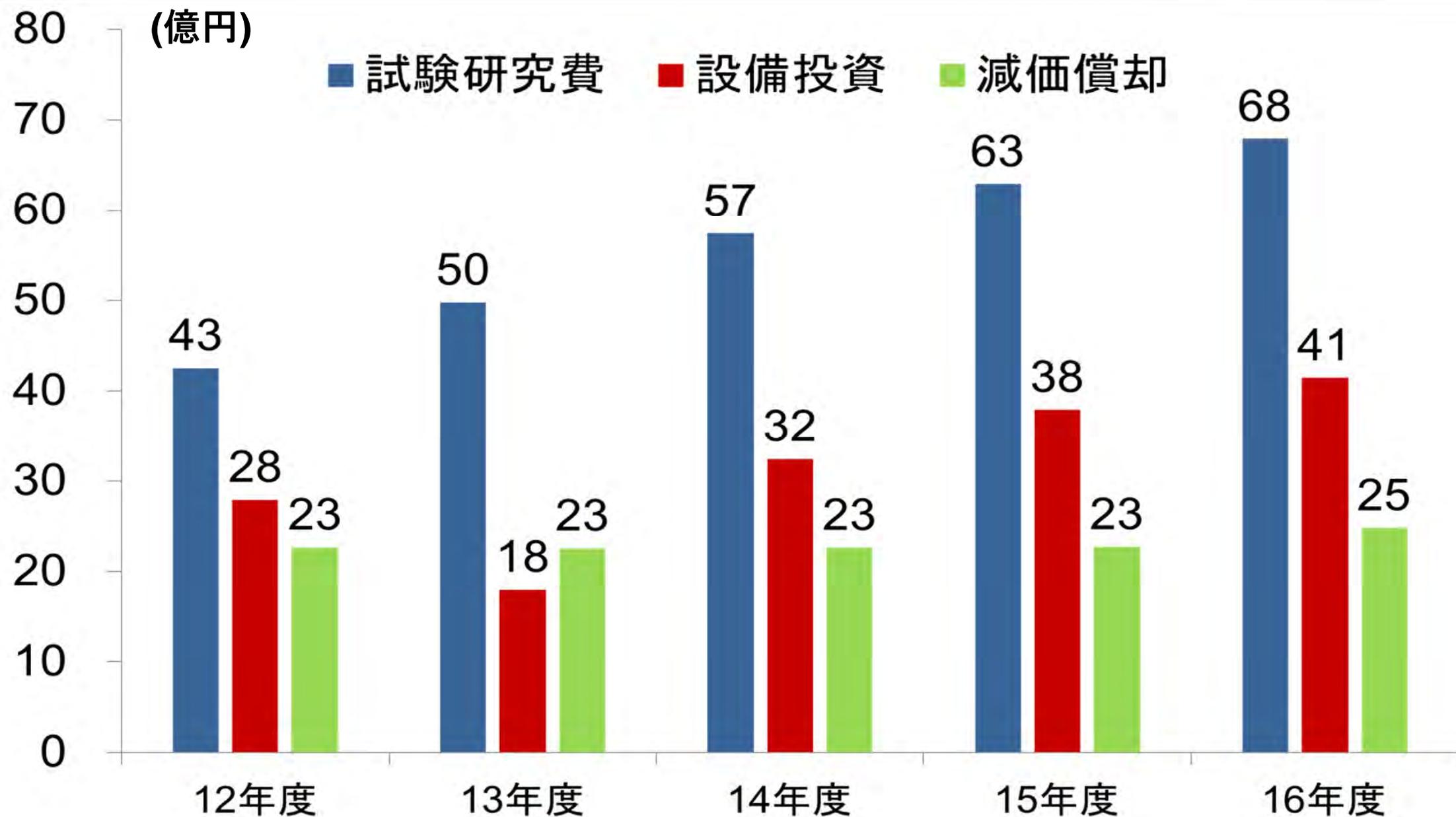


従業員数推移



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の合算

試験研究費、設備投資、減価償却



2016年度トピック

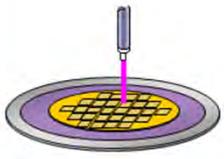
2016年5月
八王子第6工場 竣工

2017年2月7日 発表
プラズマダイシング工法の普及に向けた協業

第6工場(16年度竣工)



大型半導体装置の製造能力を大幅増強
また、アプリケーションルームを大幅拡張

対象分野	工法	
	マスク形成	ダイシング
センサー	<p>マスク貼付</p>  <p>マスク層を貼り付け</p>	<p>レーザー</p>  <p>マスク・メタル層をレーザーでカット</p> <p>東京精密</p>
メモリー		<p>プラズマ</p>  <p>ダイシング</p> <p>パナソニック</p>

© Panasonic Factory Solutions Co., Ltd. 2017

今回の協業

「レーザーグルーピング(溝加工) + プラズマダイシング工法」の普及に向け、パナソニックファクトリーソリューションズ(株)と協業

◆半導体製造装置

- 足許の市況は堅調
- メモリ・車載向けや、中国向け需要に継続期待
- スマートフォン販売動向は引き続き注視

◆計測機器

- 内需・自動車/航空機向けは引き続き堅調
- 外需(特に中国)は底打ち感が出ている
- 連動性の高い 工作機械業界が回復

2017年度 通期業績予想

単位: 億円	16年度			17年度			
	上期	下期	通期	上期 予想	下期 予想	通期 予想	前年比
売上高	372	406	778	423	367	790	+2%
半導体	243	260	503	290	220	510	+1%
計測	129	146	275	133	147	280	+2%
営業利益	66	71	137	78	62	140	+2%
同率	18%	17%	18%	18%	17%	18%	-
経常利益	63	76	139	78	62	140	+1%
親会社株主に帰属する 当期純利益	47	52	99	56	44	100	+1%
1株配当	72円			72円			±0円

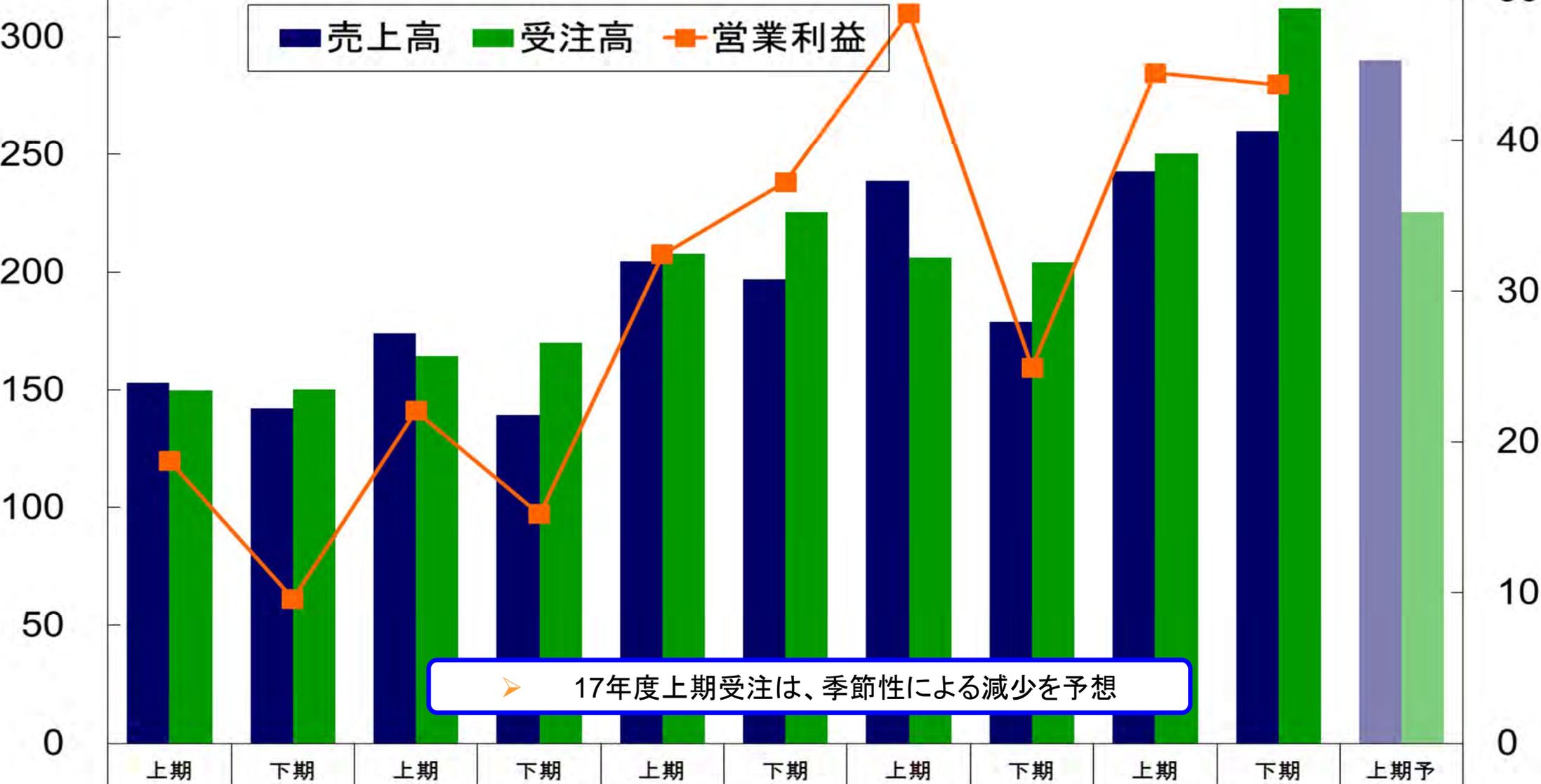


半導体事業 - 売上・受注高 見込

売上高・受注高
(億円)

営業利益(億円)

■ 売上高 ■ 受注高 ■ 営業利益



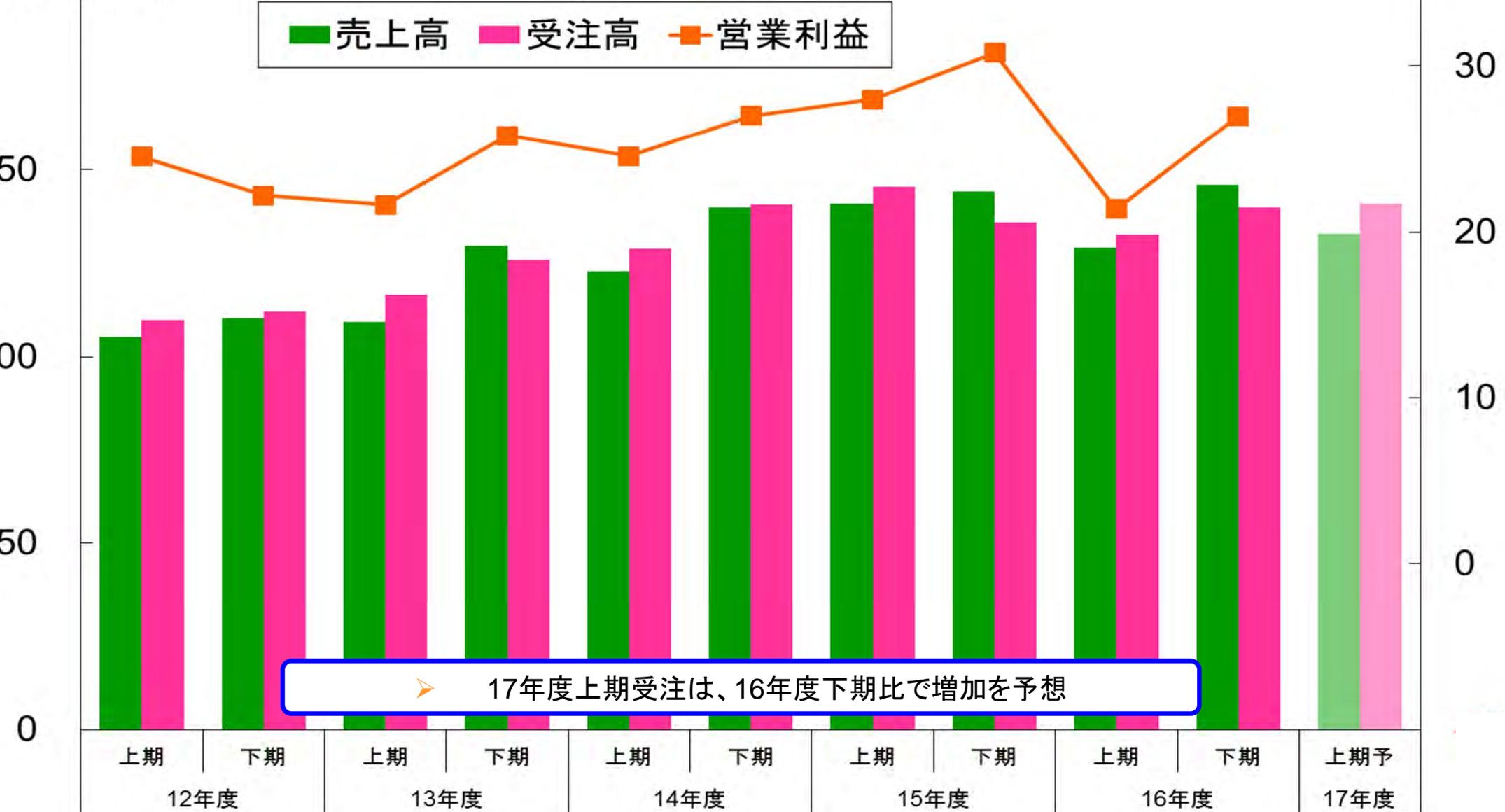
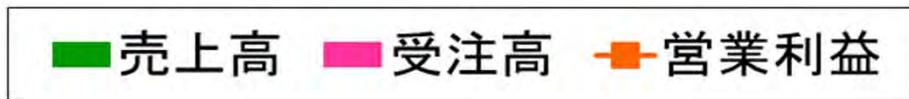
➤ 17年度上期受注は、季節性による減少を予想

計測事業 - 売上・受注高 見込

売上高・受注高

営業利益(億円)

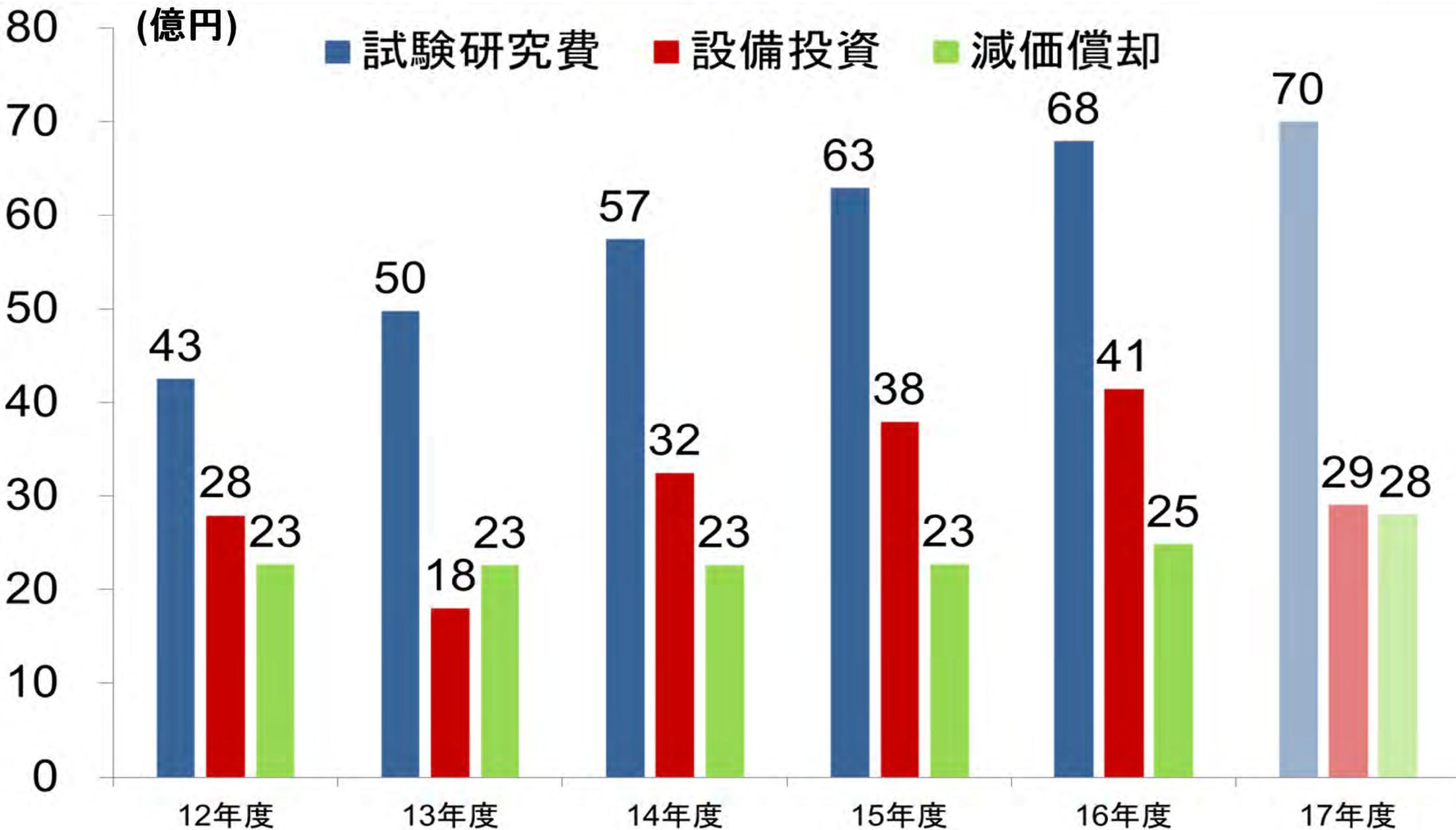
200 (億円)



➤ 17年度上期受注は、16年度下期比で増加を予想



試験研究費、設備投資、減価償却 推移・計画



企業理念

世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長してゆく

理念を示すモットー:

「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」
WIN-WIN relationships create the World's No. 1 Products

コーポレートブランド:

ACCRETECH

“Accrete (共生)” と “Technology(技術)” の合成語

企業理念実現の枠組み

業績拡大・
企業価値向上

成長投資

強固な財務基盤

CSR・内外グループガバナンス

当社事業の特長

半導体 事業

- ・ 強み: 精密位置決め制御技術、内製化
- ・ チャンス: 新技術・新デバイス

計測 事業

- ・ 強み: 高精度・高分解能測定技術、信頼性
- ・ チャンス: 新分野・新興国を含む海外需要

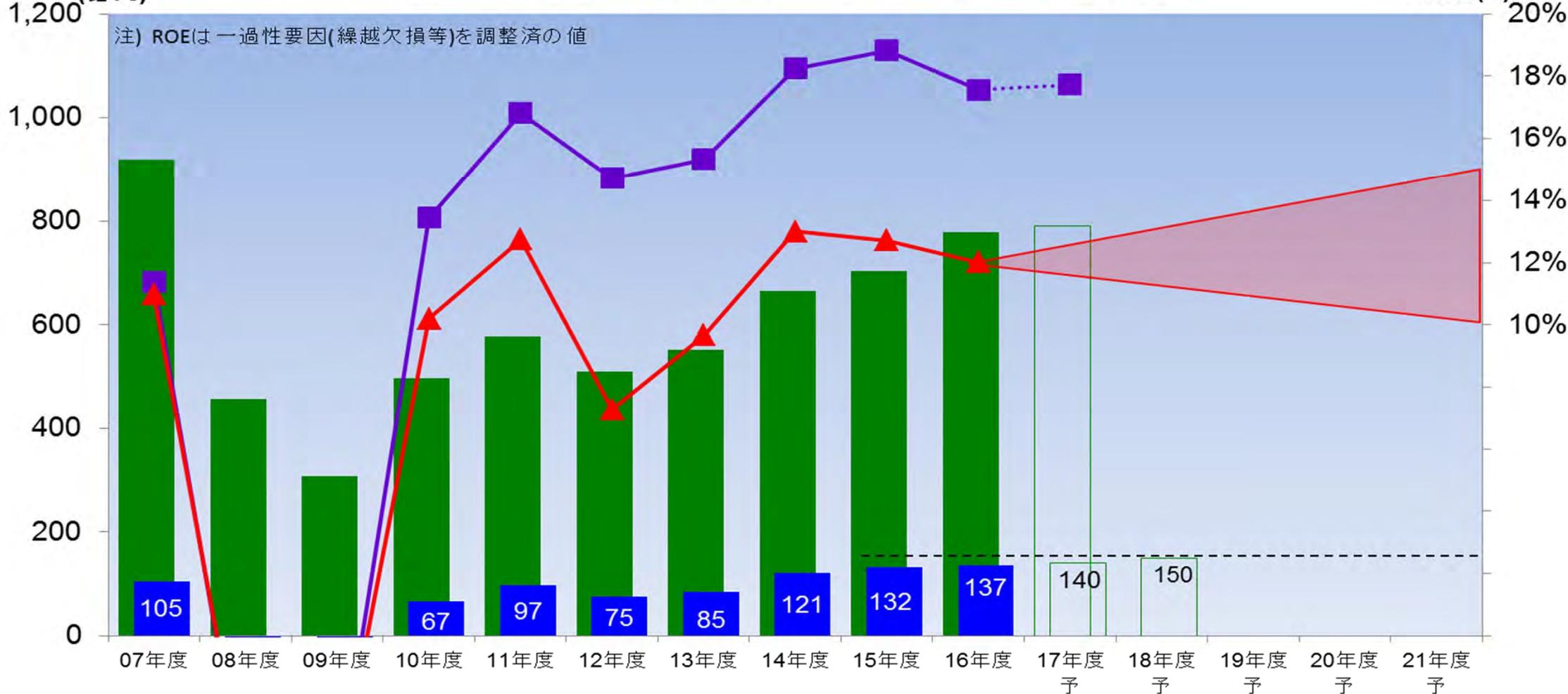
- バランスの取れた事業構成
 - 異なる事業領域を有することによる安定性(需要変動影響を吸収)

長期的な指標、中期目標

売上高、営業利益
(億円)

■ 連結売上高 ■ 営業利益 ■ 営業利益率 ▲ ROE

営業利益率、
ROE(%)



◆ 長期指標: ROE 10%以上の企業体質の維持

◆ 中期目標(~18年度): 営業利益 既往ピーク 150億円の更新

事業戦略の骨格

メインストリーム(主力マーケット)で競争力を高めつつ
安定需要・成長期待分野へ資源投下

半導体

主力市場:

- ・モバイル
- ・ストレージ
- ・自動車



安定需要・成長市場:

- ・中国市場
- ・ノンシリコン/基板
- ・消耗品



計測

主力市場:

- ・自動車及び自動車部品
- ・工作機械



安定需要・成長市場:

- ・航空機
- ・オートメーション
- ・海外市場

継続的な売上と利益の拡大

半導体事業のポイント・今後

最終製品



モバイル



ストレージ



車載デバイス



プローバ:

- 「デパート化」であらゆるニーズ対応
 - ー耐環境製品の開発・展開
 - ーメモリの生産性向上 など



ダイサ・ブレード:

- 「ソリューション力」強化
 - ー電子部品向け対応力強化
 - ー他装置との包括プロセス提案 など



PG/研削装置:

- 最先端プロセス対応
 - ー高精度、新材料(SiC、GaN等)対応強化
 - ー他装置との包括プロセス提案 など

継続的な売上と利益の拡大



新製品による 売上の拡大

安定・成長業界への製品投入
光学測定機の拡販

海外における 売上の拡大

自動化・IoT対応
世界拡販モデルの市場投入

継続的な売上と利益の拡大



東京精密は
アクレーテクです